

2014-2019年中国半导体分立器件市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国半导体分立器件市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/dianzi1404/Q87504IPOF.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-04-24

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国半导体分立器件市场分析与投资前景研究报告》共八章，报告旨在为投资者或企业管理者提供一个关于半导体分立器件产品的投资及其市场前景的深度分析，为投资者和企业管理人传递正确的投资经营理念和选择，提供一个中立、全面的投资指南手册，为半导体分立器件产品市场投资提供一个可供参照的标准。从而可以科学的帮助企业取得较高的收益。报告在全面系统分析半导体分立器件产品市场的基础上，按照专业的投资评估方法，站在第三方角度客观公正地对半导体分立器件产品的投资进行评价。为企业的投资决策提供了重要的依据。

本报告详述了半导体分立器件产品的行业概况、市场发展现状及半导体分立器件产品市场发展预测（未来五年市场供需及市场发展趋势），并且在研究半导体分立器件市场竞争、原材料、客户分析的基础上，对半导体分立器件行业投资前景及投资价值进行了研究，并提出了我们对半导体分立器件产品投资的建议。

半导体分立器件行业属于国家重点鼓励行业,2009年,国家发改委、工业和信息化部联合下发了《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》，文件明确将覆盖产品设计、芯片制造、封装测试等环节的半导体行业整体链条作为未来三年技术进步和技术改造的重点投资方向。从我国半导体分立器件产业链分布来看,下游器件封装行业厂商较多,市场集中度相对较低,产业规模发展迅速。而上游原晶片、分立器件芯片等环节由于进入壁垒较高,涉足企业较少,导致分立器件芯片尤其是高端芯片仍需依赖进口。半导体分立器件芯片产业链环节投入的不足,将成为制约下游封装企业产能进一步扩张的瓶颈。

报告目录：

第一章 半导体分立器件制造行业发展环境分析 15

1.1 行业定义及产品分类 15

1.1.1 半导体分立器件制造行业定义 15

1.1.2 半导体分立器件制造行业产品分类 15

1.2 行业政策环境分析 15

1.2.1 行业相关政策分析 15

1.2.2 行业相关发展规划 19

1.3 行业经济环境分析 20

1.3.1 宏观经济与行业的相关性分析	20
1.3.2 宏观经济发展展望	24
1.4 行业技术环境分析	25
第二章 2013年中国半导体分立器件制造行业原材料市场分析	29
2.1 行业产业链简介	29
2.2 行业原材料市场分析	29
2.2.1 芯片市场发展情况分析	29
2.2.2 金属硅市场发展情况分析	31
2.2.3 铜材市场发展情况分析	33
2.3 原材料对行业的影响	37
第三章 2013年中国半导体分立器件制造行业现状及预测	38
3.1 半导体分立器件制造行业经营情况分析	38
3.1.1 半导体分立器件制造行业发展总体概况	38
3.1.2 半导体分立器件制造行业发展主要特点	38
3.1.3 半导体分立器件制造行业市场规模分析	39
3.1.4 半导体分立器件制造行业财务指标分析	40
(1) 半导体分立器件制造行业盈利能力分析	40
(2) 半导体分立器件制造行业运营能力分析	41
(3) 半导体分立器件制造行业偿债能力分析	41
(4) 半导体分立器件制造行业发展能力分析	42
3.1.5 行业不同规模企业主要经济指标分析	42
3.1.6 行业不同性质企业主要经济指标分析	44
3.2 半导体分立器件制造行业供需平衡分析	47
3.2.1 全国半导体分立器件制造行业供给情况分析	47
(1) 全国半导体分立器件制造行业总产值分析	47
(2) 全国半导体分立器件制造行业产成品分析	48
3.2.2 全国半导体分立器件制造行业需求情况分析	48
(1) 全国半导体分立器件制造行业销售产值分析	49
(2) 全国半导体分立器件制造行业销售收入分析	49
3.2.3 全国半导体分立器件制造行业产销率分析	50

3.3 2013年半导体分立器件制造行业运营状况分析	51
3.3.1 2013年行业产业规模分析	51
3.3.2 2013年行业资本/劳动密集度分析	51
3.3.3 2013年行业产销分析	52
3.3.4 2013年行业成本费用结构分析	52
3.3.5 2013年行业盈亏分析	53
3.4 半导体分立器件制造行业进出口市场分析	53
3.4.1 半导体分立器件制造行业进出口状况综述	53
3.4.2 半导体分立器件制造行业出口产品结构	54
3.4.3 半导体分立器件制造行业进口产品结构	55
3.4.4 半导体分立器件制造行业进出口前景及建议	57
3.5 2014-2019年半导体分立器件制造行业发展前景预测	58
3.5.1 半导体分立器件制造行业发展的驱动因素	58
3.5.2 半导体分立器件制造行业发展的障碍因素	58
3.5.3 半导体分立器件制造行业发展趋势分析	59
3.5.4 2014-2019年半导体分立器件制造行业前景预测	60

第四章2013年中国半导体分立器件制造行业竞争格局分析 62

4.1 行业总体竞争状况分析	62
4.2 行业国际市场竞争状况分析	62
4.2.1 国际半导体分立器件市场发展状况	62
4.2.2 国际半导体分立器件市场竞争状况	63
4.2.3 国际半导体分立器件市场发展趋势	63
4.2.4 跨国公司在中国市场的投资布局	64
(1) 日本厂商在华投资布局分析	64
1) 东芝 (TOSHIBA)	64
2) 瑞萨科技 (RENESAS)	65
3) 罗姆 (Rohm)	66
4) 松下 (Panasonic)	66
5) 日本电气股份有限公司 (NEC)	67
(2) 美国厂商在华投资布局分析	71
1) 威旭 (Vishay)	71

2) 飞兆半导体 (Fairchild Semiconductors)	71
3) 国际整流器公司 (International Rectifier)	72
(3) 欧洲厂商在华投资布局分析	73
1) 飞利浦半导体 (Philips Semiconductors)	73
2) 意法半导体 (ST Microelectronics)	73
3) 英飞凌 (Infineon Technologies)	74
4.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析	75
4.3 行业国内市场竞争状况分析	76
4.3.1 国内半导体分立器件制造行业集中度	76
4.3.2 国内半导体分立器件制造行业竞争格局	78
4.3.3 行业国内市场五力模式分析	79

第五章2013年中国半导体分立器件应用市场发展情况分析 83

5.1 半导体分立器件产品概况	83
5.1.1 行业产品结构特征分析	83
5.1.2 半导体分立器件产量分析	83
5.2 半导体分立器件应用市场分析	83
5.2.1 电子设备制造对半导体分立器件需求分析	84
5.2.2 LED显示屏对半导体分立器件需求分析	85
5.2.3 电子照明对半导体分立器件需求分析	87
5.2.4 汽车电子对半导体分立器件需求分析	88

第六章2013年中国半导体分立器件制造行业重点区域市场分析 91

6.1 行业区域市场总体发展状况	91
6.1.1 行业区域结构总体特征	91
6.1.2 行业区域集中度分析	92
6.2 行业重点区域经营情况分析	93
6.2.1 华北地区半导体分立器件制造行业经营情况	93
6.2.2 东北地区半导体分立器件制造行业经营情况	98
6.2.3 华东地区半导体分立器件制造行业经营情况	102
6.2.4 华中地区半导体分立器件制造行业经营情况	113
6.2.5 华南地区半导体分立器件制造行业经营情况	118

6.2.6 其他地区半导体分立器件制造行业经营情况 121

第七章 半导体分立器件制造领先企业生产经营分析 127

7.1 半导体分立器件制造企业概况 127

7.1.1 企业销售收入情况 127

7.1.2 企业利润总额情况 127

7.2 半导体分立器件制造行业领先企业个案分析 128

7.2.1 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析 128

(1) 企业发展简况分析 128

(2) 企业产销能力分析 129

(3) 企业盈利能力分析 129

(4) 企业运营能力分析 130

(5) 企业偿债能力分析 130

(6) 企业发展能力分析 131

7.2.2 上海松下半导体有限公司经营情况分析 132

7.2.3 苏州松下半导体有限公司经营情况分析 135

7.2.4 无锡华润华晶微电子有限公司经营情况分析 139

7.2.5 恩智浦半导体广东有限公司经营情况分析 143

第八章 2014-2019年中国半导体分立器件制造行业投资分析与建议 253

8.1 半导体分立器件制造行业投资特性分析 253

8.1.1 半导体分立器件制造行业进入壁垒分析 253

8.1.2 半导体分立器件制造行业盈利模式分析 254

8.1.3 半导体分立器件制造行业盈利因素分析 254

8.2 半导体分立器件制造行业投资兼并分析 255

8.2.1 行业投资兼并与重组整合概况 255

8.2.2 国内企业投资兼并与重组整合 256

8.2.3 行业投资兼并与重组整合特征 257

8.3 半导体分立器件制造行业投资机会与建议 257

8.3.1 半导体分立器件制造行业投资风险 257

8.3.2 半导体分立器件制造行业投资机会 259

8.3.3 半导体分立器件制造行业投资建议 259

图表目录：（部分）

图表：半导体分立器件制造行业上下游产业关系图

图表：分立器件市场应用结构（单位：%）

图表：2013年中国铜材月度产量（单位：万吨）

图表：2013年规模以上电子信息制造业与全国工业增加值月增速对比（单位：%）

图表：2013年规模以上电子信息制造业营业收入和利润完成情况对比（单位：亿元，%）

图表：电子信息产品月度出口额情况（单位：亿美元，%）

图表：2012年中国电子计算机制造业主要经济指标（单位：家，万元，%）

图表：2006-2012年中国移动基站设备增长情况（单位：万信道）

图表：2008-2012年国内电信固定资产投资情况（单位：亿元）

图表：2012年中国通信设备制造业主要经济指标（单位：家，万元，%）

图表：2010-2016年全球LED显示屏市场规模及预测（单位：亿美元，%）

图表：2010-2016年中国LED显示屏市场规模及预测（单位：亿元，%）

图表：2010-2016年中国LED照明市场规模及预测（单位：亿元，%）

图表14：部分国家白炽灯淘汰时间表

图表：2011-2013年深圳赛意法微电子有限公司主要经济指标走势

图表：2011-2013年深圳赛意法微电子有限公司经营收入走势

图表：2011-2013年深圳赛意法微电子有限公司盈利指标走势

图表：2011-2013年深圳赛意法微电子有限公司负债情况

图表：2011-2013年深圳赛意法微电子有限公司负债指标走势

图表：2011-2013年深圳赛意法微电子有限公司运营能力指标走势

图表：2011-2013年深圳赛意法微电子有限公司成长能力指标走势

图表：2011-2013年上海松下半导体有限公司主要经济指标走势

图表：2011-2013年上海松下半导体有限公司经营收入走势

图表：2011-2013年上海松下半导体有限公司盈利指标走势

图表：2011-2013年上海松下半导体有限公司负债情况

图表：2011-2013年上海松下半导体有限公司负债指标走势

图表：2011-2013年上海松下半导体有限公司运营能力指标走势

图表：2011-2013年上海松下半导体有限公司成长能力指标走势

图表：2011-2013年无锡华润华晶微电子有限公司主要经济指标走势

图表：2011-2013年无锡华润华晶微电子有限公司经营收入走势

图表：2011-2013年无锡华润华晶微电子有限公司盈利指标走势

图表：2011-2013年无锡华润华晶微电子有限公司负债情况

图表：2011-2013年无锡华润华晶微电子有限公司负债指标走势

图表：2011-2013年无锡华润华晶微电子有限公司运营能力指标走势

图表：2011-2013年无锡华润华晶微电子有限公司成长能力指标走势

图表：2011-2013年苏州松下半导体有限公司主要经济指标走势

图表：2011-2013年苏州松下半导体有限公司经营收入走势

图表：2011-2013年苏州松下半导体有限公司盈利指标走势

图表：2011-2013年苏州松下半导体有限公司负债情况

图表：2011-2013年苏州松下半导体有限公司负债指标走势

图表：2011-2013年苏州松下半导体有限公司运营能力指标走势

图表：2011-2013年苏州松下半导体有限公司成长能力指标走势

图表：2011年1-12月中国半导体分立器件行业全部企业数据分析

图表：2012年中国半导体分立器件行业全部企业数据分析

图表：2013年中国半导体分立器件行业全部企业数据分析

图表：2011年1-12月中国半导体分立器件行业不同规模企业数据分析

图表：2012年1-12月中国半导体分立器件行业不同规模企业数据分析

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件行业不同规模企业数据分析

图表：2011年1-12月中国半导体分立器件行业不同所有制企业数据分析

图表：2012年1-12月中国半导体分立器件行业不同所有制企业数据分析

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件行业不同所有制企业数据分析

图表：分地区投资相邻两月累计同比增速

图表：2012-2013年12月固定资产投资（不含农户）同比增速

图表：2012-2013年12月固定资产投资到位资金同比增速

图表：2013年1-12月份固定资产投资（不含农户）主要数据

图表：2012年12月-2013年12月全国居民消费价格涨跌幅

图表：2012年12月-2013年12月鲜菜与鲜果价格变动情况

图表：2013年12月份居民消费价格分类别同比涨跌幅

图表：2013年12月份居民消费价格分类别环比涨跌幅

图表：2013年12月居民消费价格主要数据

图表：2012年12月-2013年12月规模以上工业增加值同比增长速度

图表：2013年12月份规模以上工业生产主要数据

图表：2012年12月-2013年12月发电量日均产量及同比增速

图表：2012年12月-2013年12月钢材日均产量及同比增速

图表：2012年12月-2013年12月汽车日均产量及同比增速

图表：2012年12月-2013年12月轿车日均产量及同比增速

图表：2012-2013年12月全国房地产投资开发增速

图表：2012-2013年12月全国房地产开发企业土地购置面积增速

图表：2012-2013年12月全国商品房销售面积及销售额统计

图表：2012-2013年12月全国房地产开发企业本年到位资金增速

图表：2013年1-12月份全国房地产开发和销售情况

图表：2013年1-12月份东中西部地区房地产开发投资情况

图表：2013年1-12月份东中西部地区房地产销售情况

图表：中国制造业PMI指数走势图

本报告以定量研究为主，定量与定性研究相结合的方法，深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息，采用统计图表等多种形式将研究结果清晰、直观的展现出来，多方位、多角度保证了报告内容的系统性和完整性，为企业的发展和半导体分立器件的投资提供了决策依据

。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/dianzi1404/Q87504IPOF.html>